

2018年3月期 第2四半期決算説明会

WAIDA



(高山市街と乗鞍岳)

Photo by : Ikedo Hiroshi

株式会社 和井田製作所
2017年12月1日

証券コード : 6158

飛騨高山

1300年の匠の技

摺り合わせ技術

会 社 名	株式会社 和井田製作所	事 業 内 容	特殊研削盤の製造・販売
本 社	岐阜県高山市片野町2121番地	資 本 金	8億4,330万円
代 表 者	代表取締役会長兼社長 和井田光生	従 業 員 数	163名(連結) 135名(単体)
設 立	1946年10月(現在第89期目)	所 属 団 体	(一社)日本工作機械工業会

- **2018年3月期 第2四半期 決算概要**
- **2018年3月期 通期 業績見通し**
- **経営課題の進捗状況**

2018年3月期 第2四半期 決算概要



(合掌造りと稲穂)

※ 金額表示は単位未満切り捨てております。
%表示は四捨五入しております。

決算ハイライト（連結）

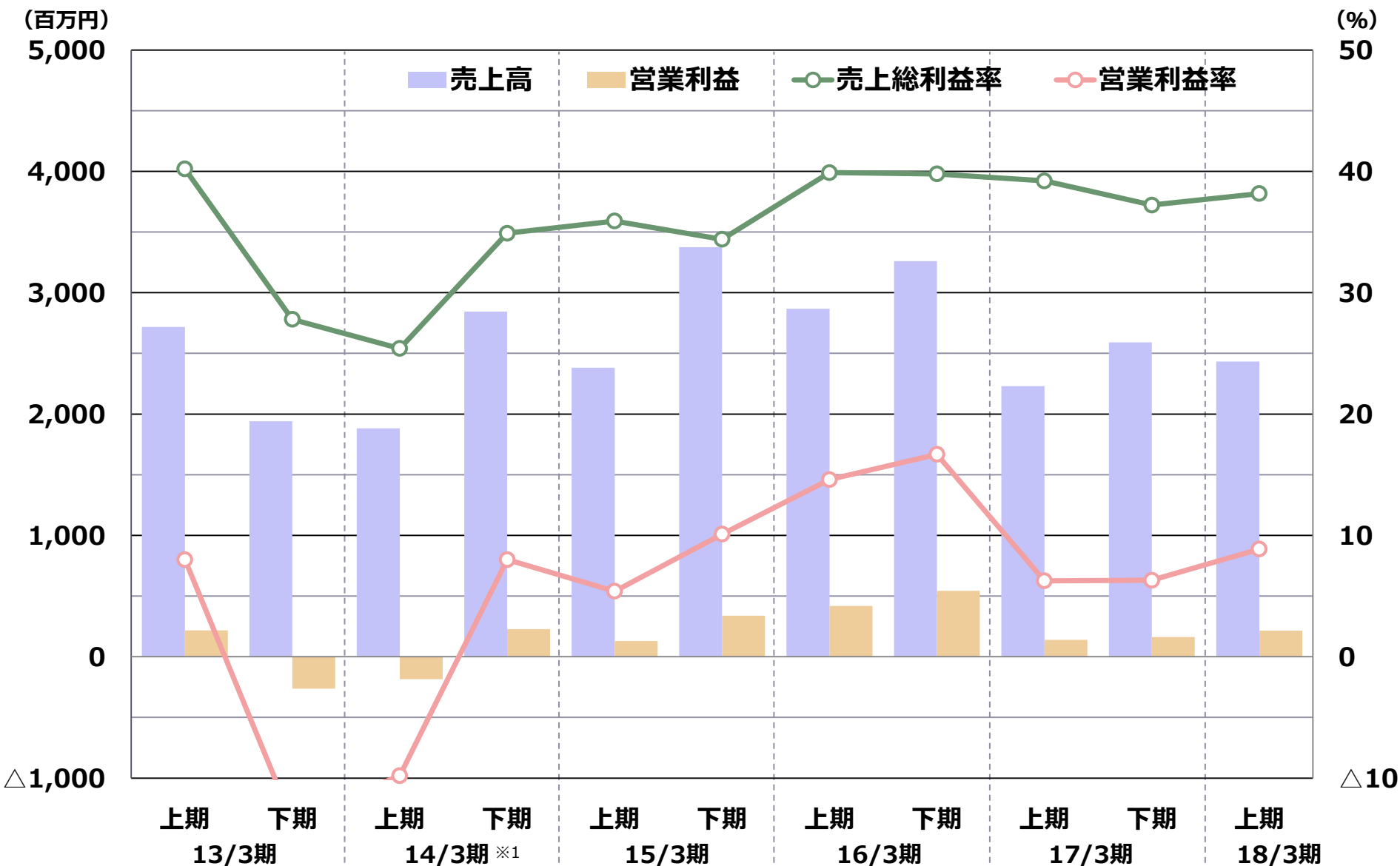
（単位：百万円）

	17/3期 上半期 実績	18/3期 上半期 期初計画※1	18/3期 上半期 実績	前年同期比	期初計画比
売 上 高	2,230	2,442	2,433	109.1%	99.6%
売 上 原 価	1,355	1,528	1,504	111.0%	98.4%
売 上 総 利 益	874	913	928	106.2%	101.7%
〔売上総利益率〕	39.2%	37.4%	38.2%	▲1.0ポイント	+0.8ポイント
販 売 管 理 費	735	764	712	97.0%	93.3%
営 業 利 益	139	149	215	154.8%	144.7%
〔営業利益率〕	6.3%	6.1%	8.9%	+2.6ポイント	+2.8ポイント
経 常 利 益	134	154	230	171.3%	149.6%
〔経常利益率〕	6.0%	6.3%	9.5%	+3.4ポイント	+3.2ポイント
四半期純利益※2	71	105	166	235.0%	157.6%
〔四半期純利益率〕	3.2%	4.3%	6.9%	+3.7ポイント	+2.5ポイント

※1 2017/5/11 開示

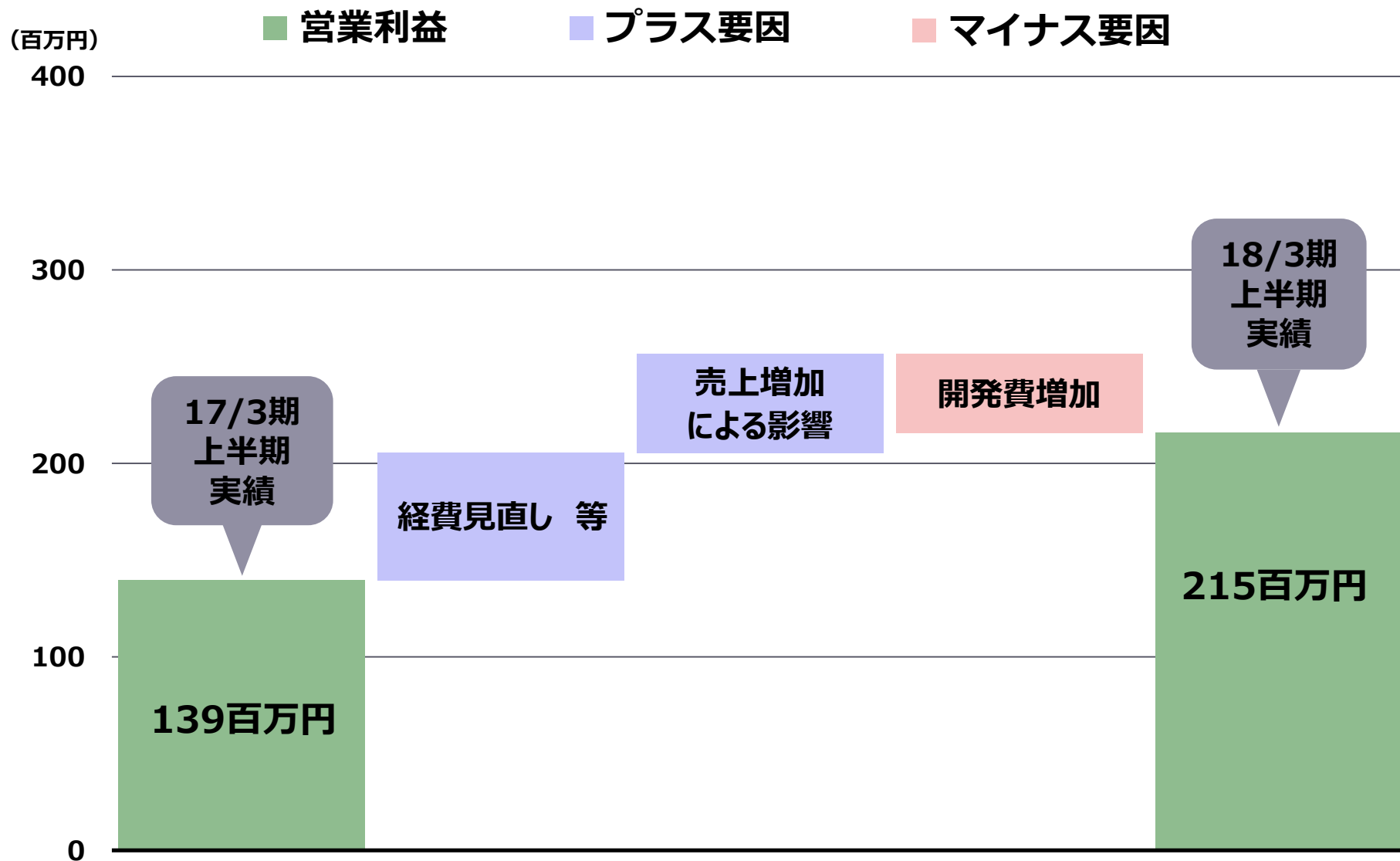
※2 「親会社株主に帰属する四半期純利益」を「四半期純利益」として表示しております

業績推移（連結）（※1）

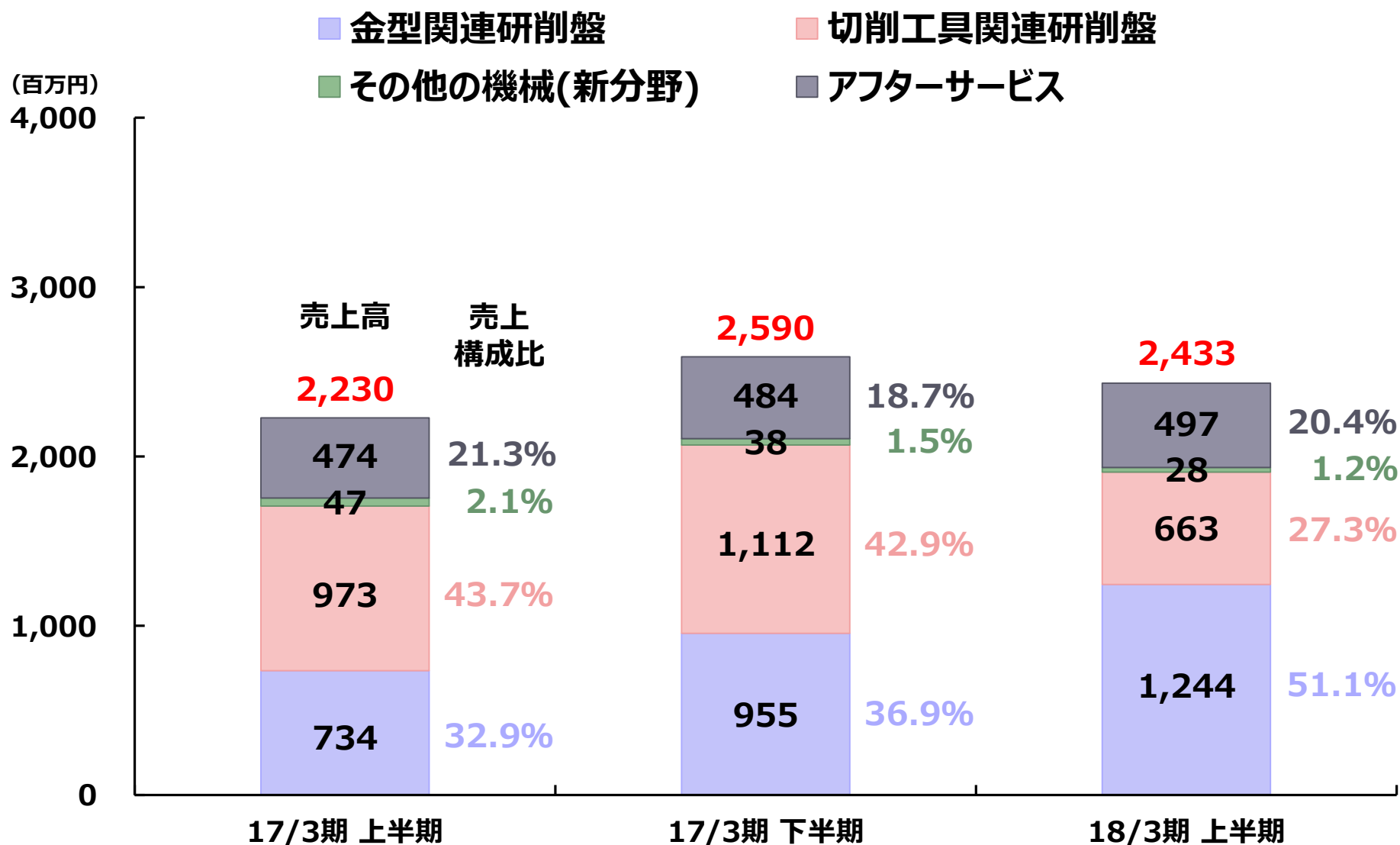


※1 14/3期から売上計上基準を変更しております。グラフ内の数値は過年度遡及適用前のものを使用しております。

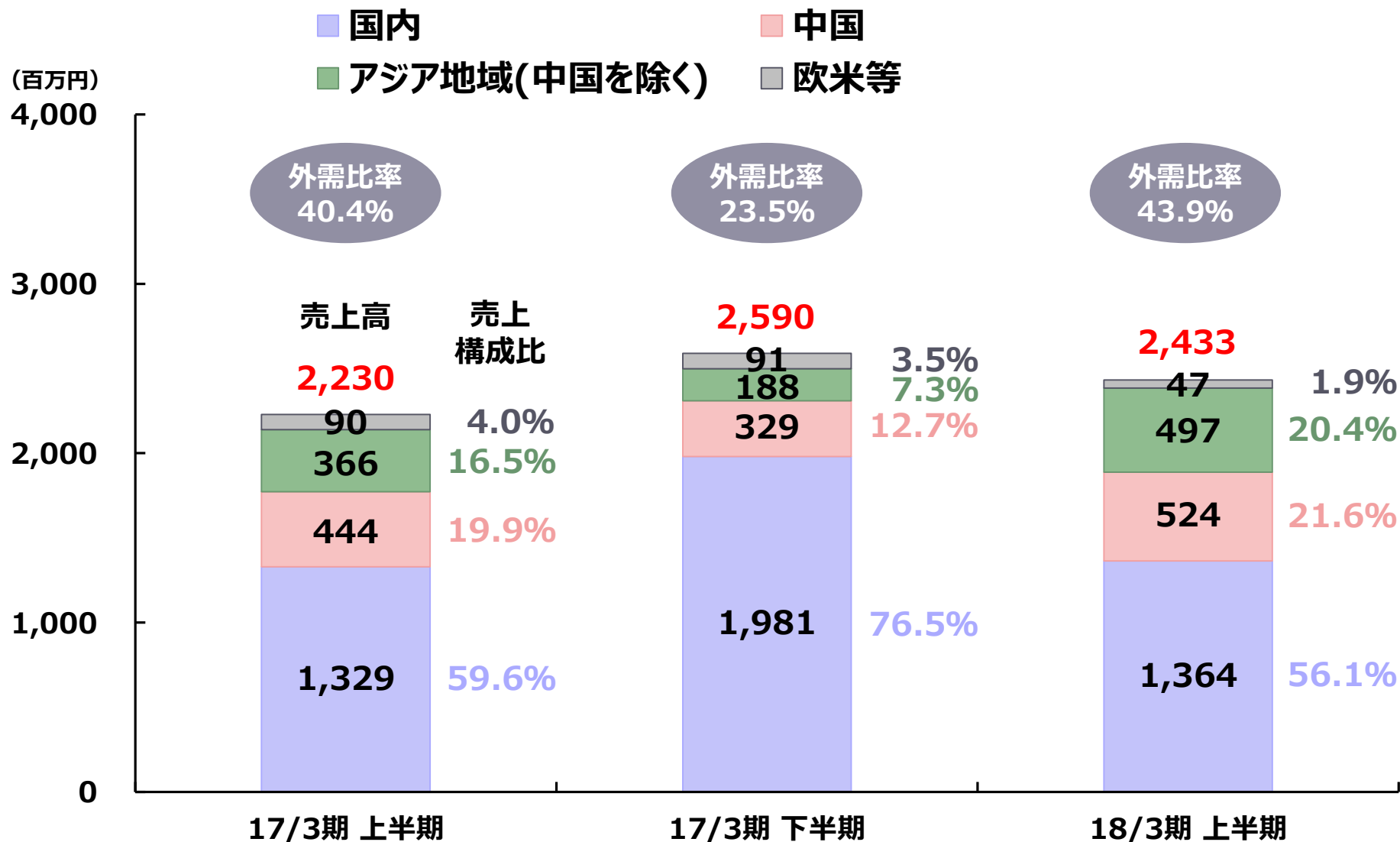
営業利益増減要因（前年同期比 連結）



品目別売上高（連結）



地域別売上高（連結）（※）



※ 最終据付地ベースで集計しております。

貸借対照表（連結）

＜資産の部＞

（単位：百万円）

	17/3期 期末 (17/3/31) 実績	18/3期 上半期末 (17/9/30) 実績	増減
現金・預金	2,539	3,079	540
売上債権	1,499	1,218	▲281
たな卸資産	1,659	1,843	184
その他流動資産	130	108	▲21
流動資産合計	5,829	6,251	421
有形固定資産	2,082	1,984	▲98
その他固定資産	422	442	19
固定資産合計	2,504	2,426	▲78
資産合計	8,334	8,677	342

＜負債・純資産の部＞

（単位：百万円）

	17/3期 期末 (17/3/31) 実績	18/3期 上半期末 (17/9/30) 実績	増減
仕入債務	366	667	300
有利子負債(短期)	785	666	▲119
その他流動負債	370	343	▲27
流動負債合計	1,522	1,676	154
有利子負債(長期)	820	878	58
その他固定負債	369	361	▲8
固定負債合計	1,189	1,240	50
負債合計	2,712	2,917	204
純資産合計	5,622	5,760	138
負債・純資産合計	8,334	8,677	342

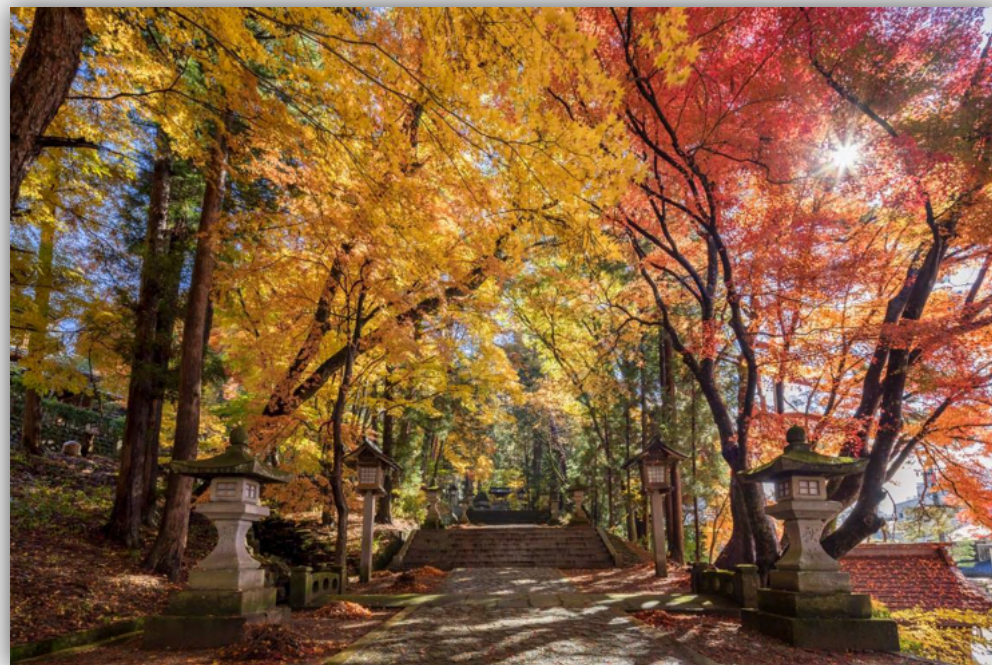
キャッシュ・フロー（連結）

（単位：百万円）

	17/3期 上半期 (16/4/1～9/30) 実績	18/3期 上半期 (17/4/1～9/30) 実績
営業活動によるキャッシュ・フロー	79	742
投資活動によるキャッシュ・フロー	52	▲28
フリー・キャッシュ・フロー（※）	132	714
財務活動によるキャッシュ・フロー	198	▲168
現金及び現金同等物に係る換算差額	▲10	▲5
現金及び現金同等物の増減額	320	540
現金及び現金同等物期首残高	1,678	2,198
現金及び現金同等物期末残高	1,999	2,738

※ フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー

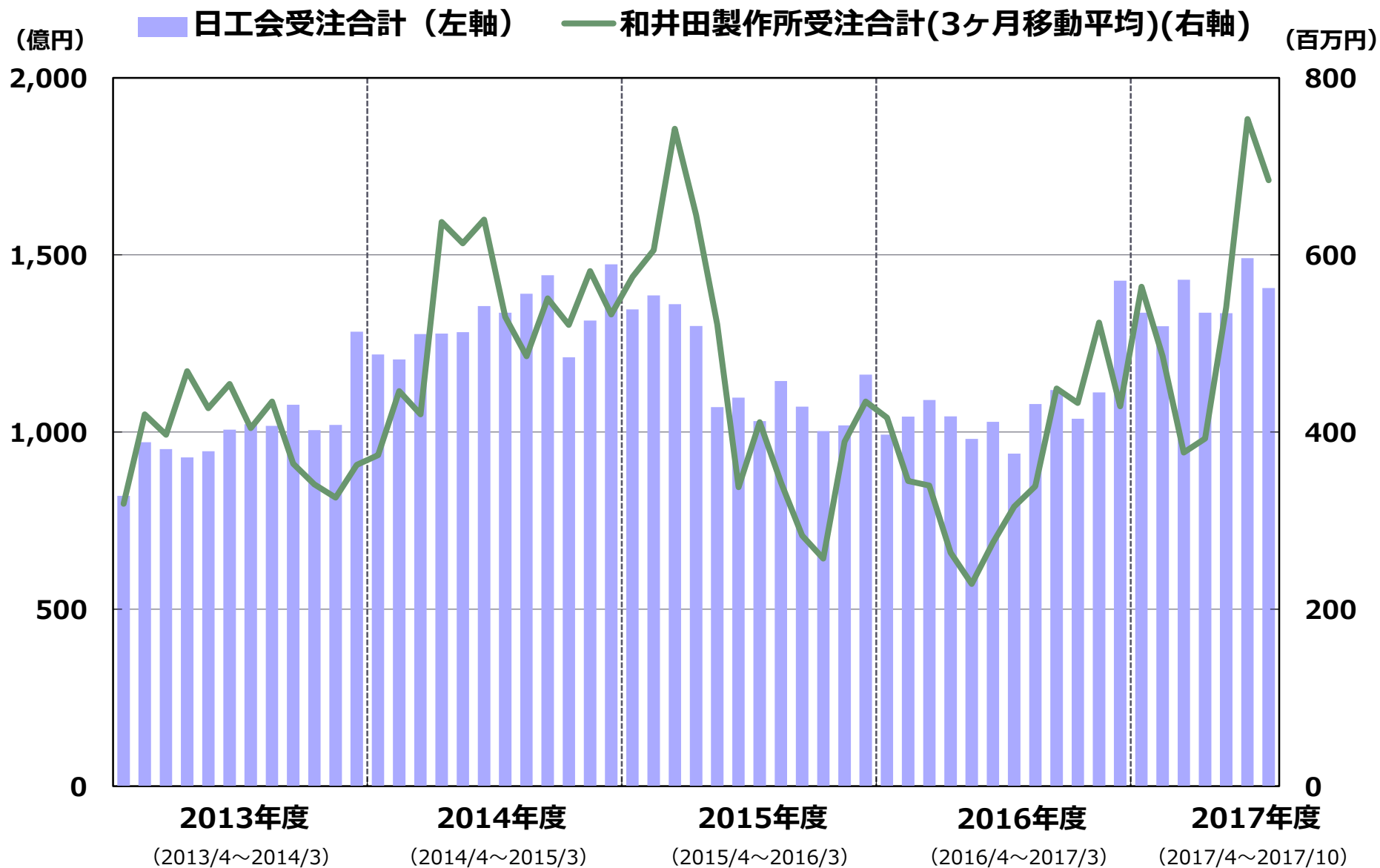
2018年3月期 通期 業績見通し



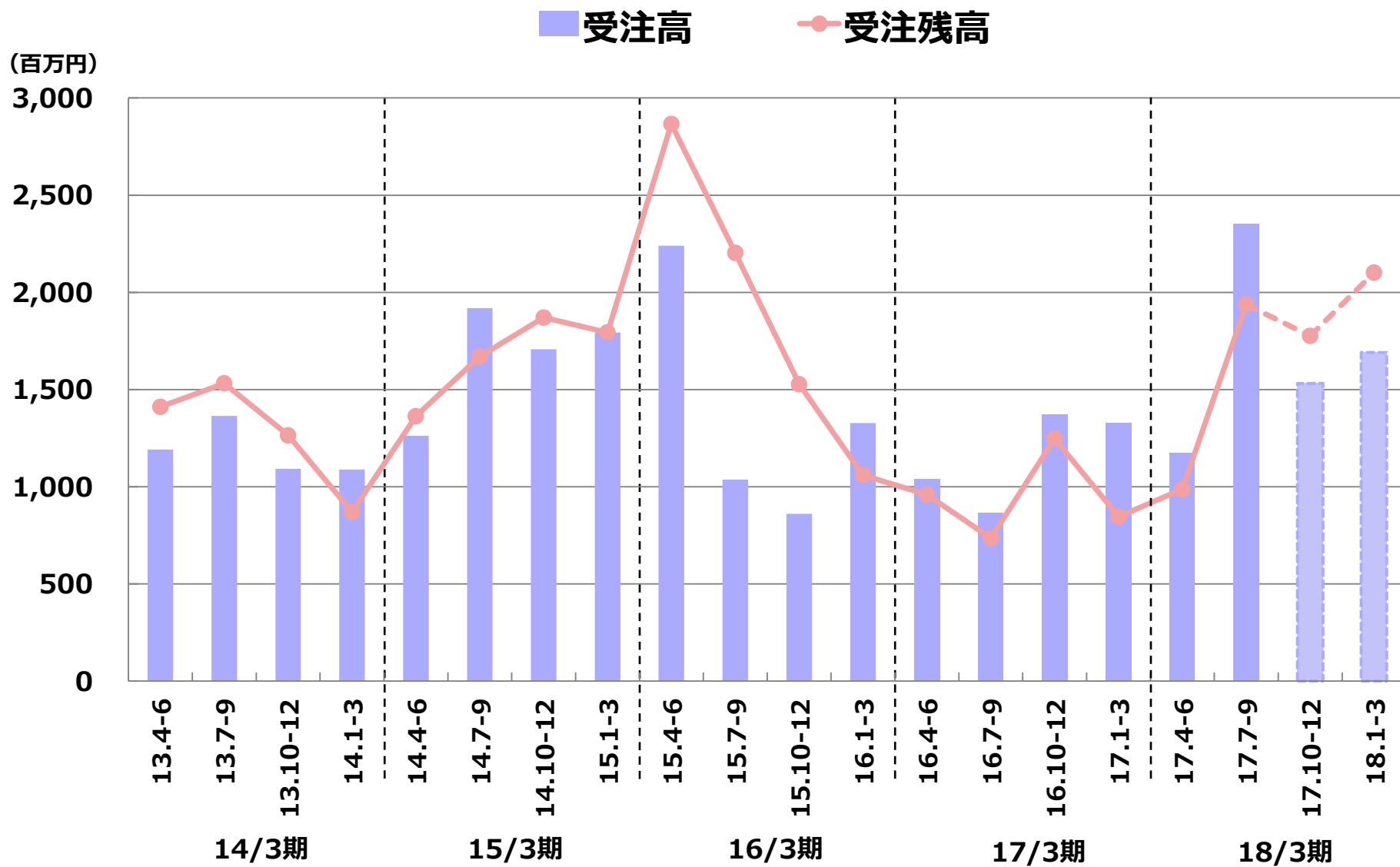
(紅葉の日枝神社)

※ 金額表示は単位未満切り捨てております。
%表示は四捨五入しております。

日工会／当社 月別受注比較



当社 受注高・受注残高（連結）の推移



※ 14/3期から会計方針の変更（売上計上基準の変更）を反映した遡及適用後の数値

業績見通し（連結）

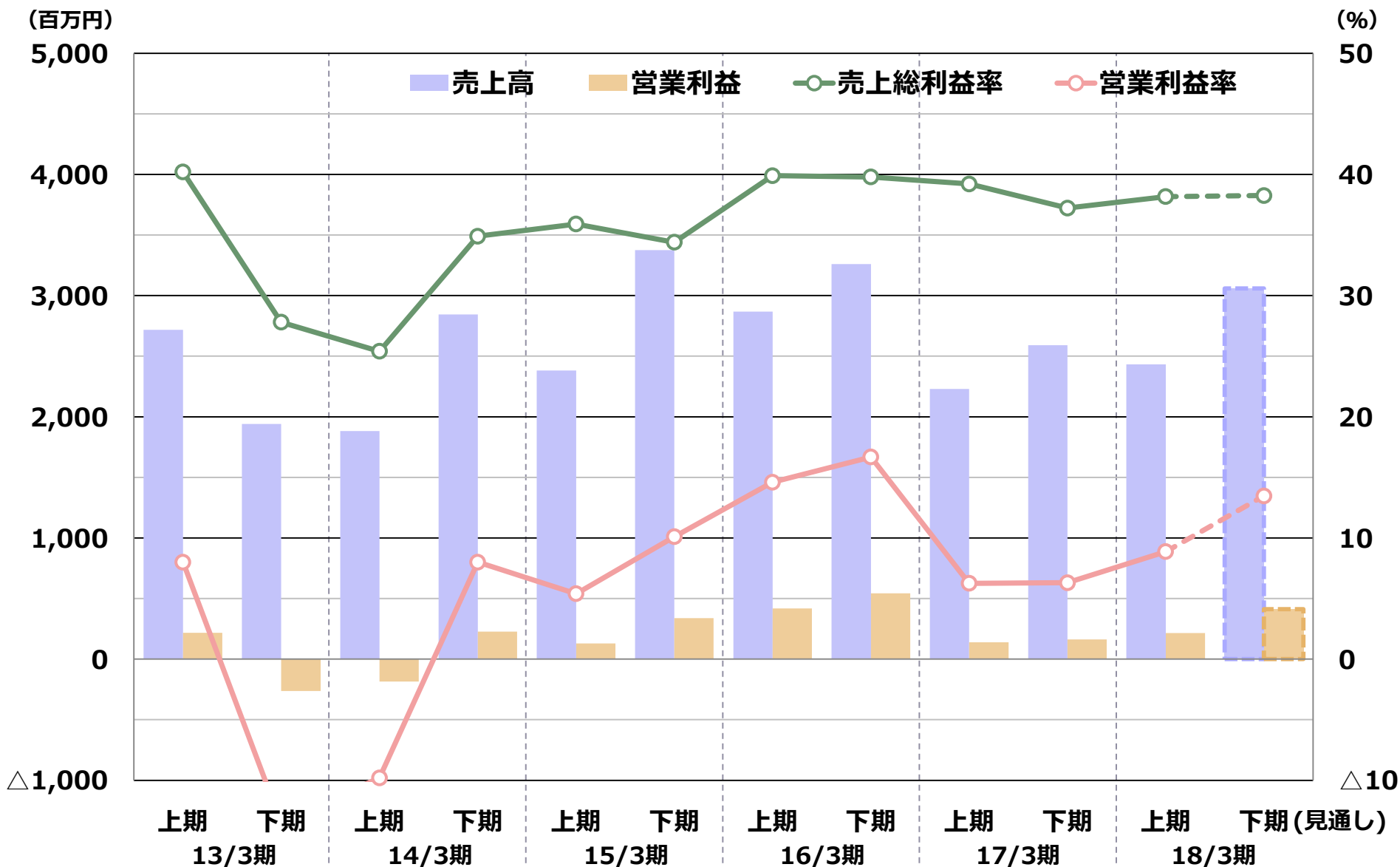
（単位：百万円）

	17/3期 通期 実績	18/3期 通期 見通し※1	上半期 実績	下半期 見通し
売 上 高	4,821	5,492	2,433	3,059
売 上 原 価	2,982	3,393	1,504	1,889
売 上 総 利 益	1,839	2,098	928	1,170
〔売上総利益率〕	38.1%	38.2%	38.2%	38.3%
販 売 管 理 費	1,536	1,471	712	758
営 業 利 益	302	627	215	411
〔営業利益率〕	6.3%	11.4%	8.9%	13.5%
経 常 利 益	312	647	230	416
〔経常利益率〕	6.5%	11.8%	9.5%	13.6%
当 期 純 利 益※2	189	450	166	283
〔当期純利益率〕	3.9%	8.2%	6.9%	9.3%
配当金（1株当たり）	年間 16円 記念配 2円含む	年間 18円(予定)	中間 7円	期末 11円(予定)

※1 2017/11/2 開示

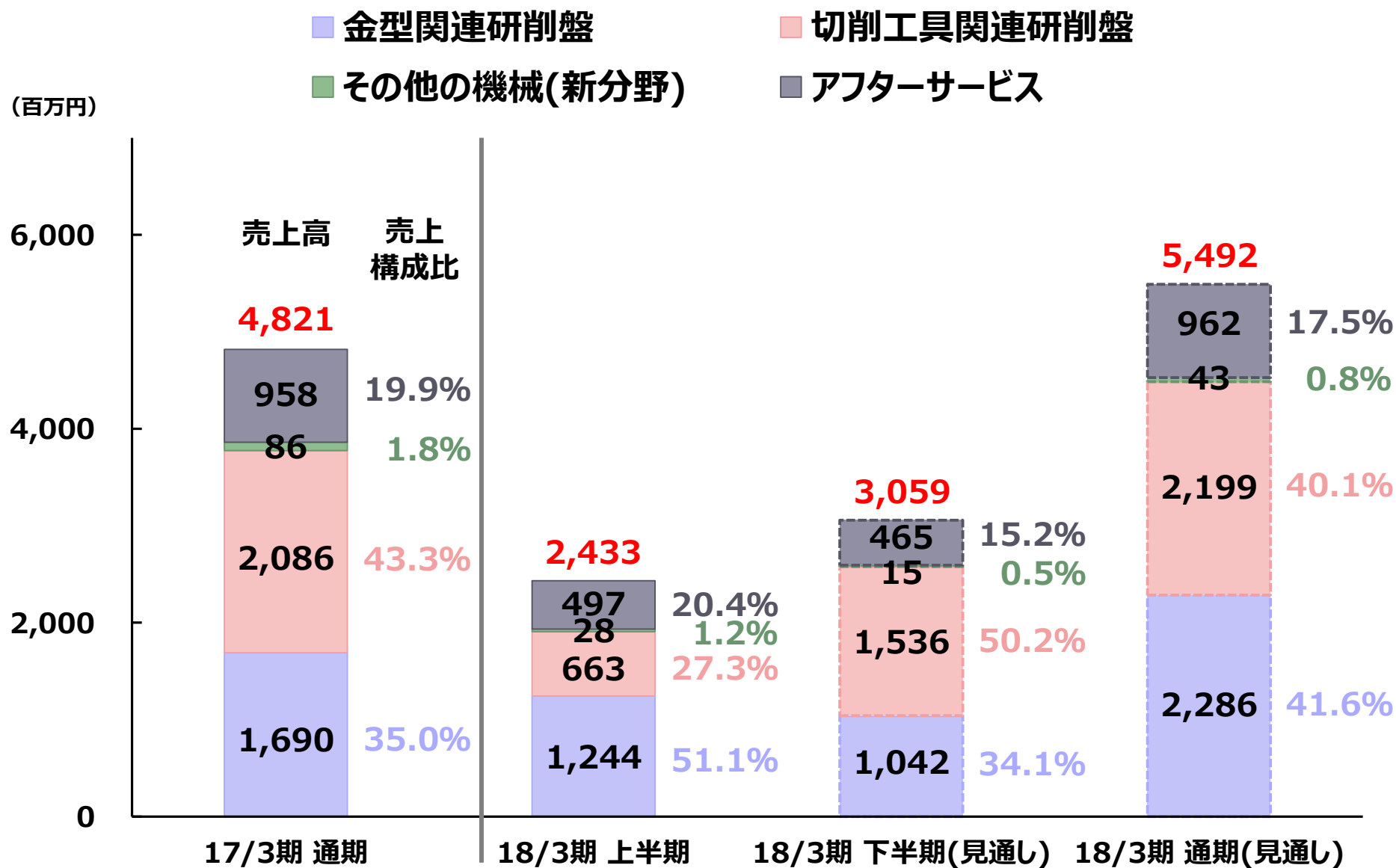
※2 「親会社株主に帰属する当期純利益」を「当期純利益」として表示しております

業績推移見通し（連結）（※1）

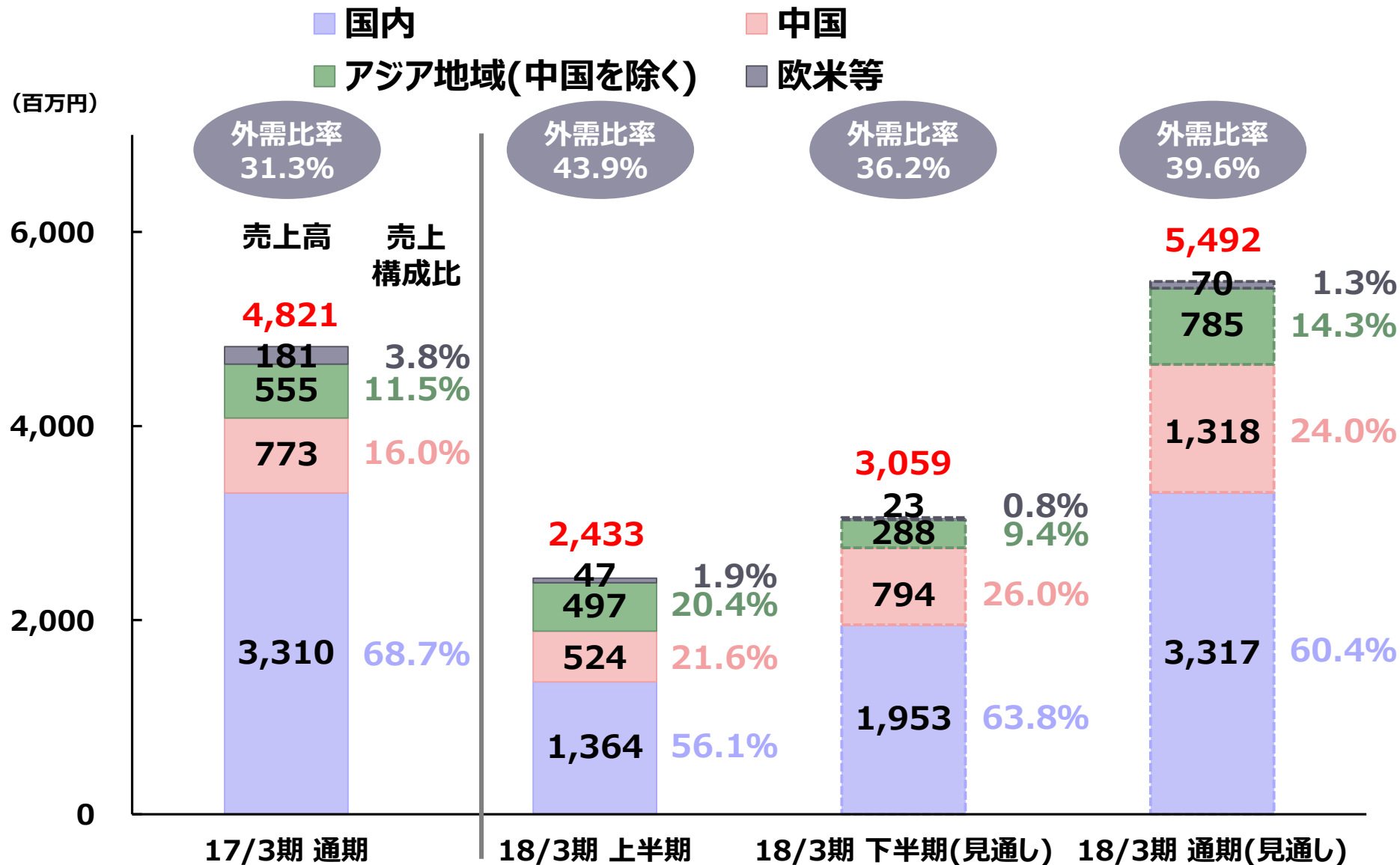


※1 14/3期から売上計上基準を変更しております。グラフ内の数値は過年度遡及適用前のもを使用しております。

品目別売上高見通し（連結）

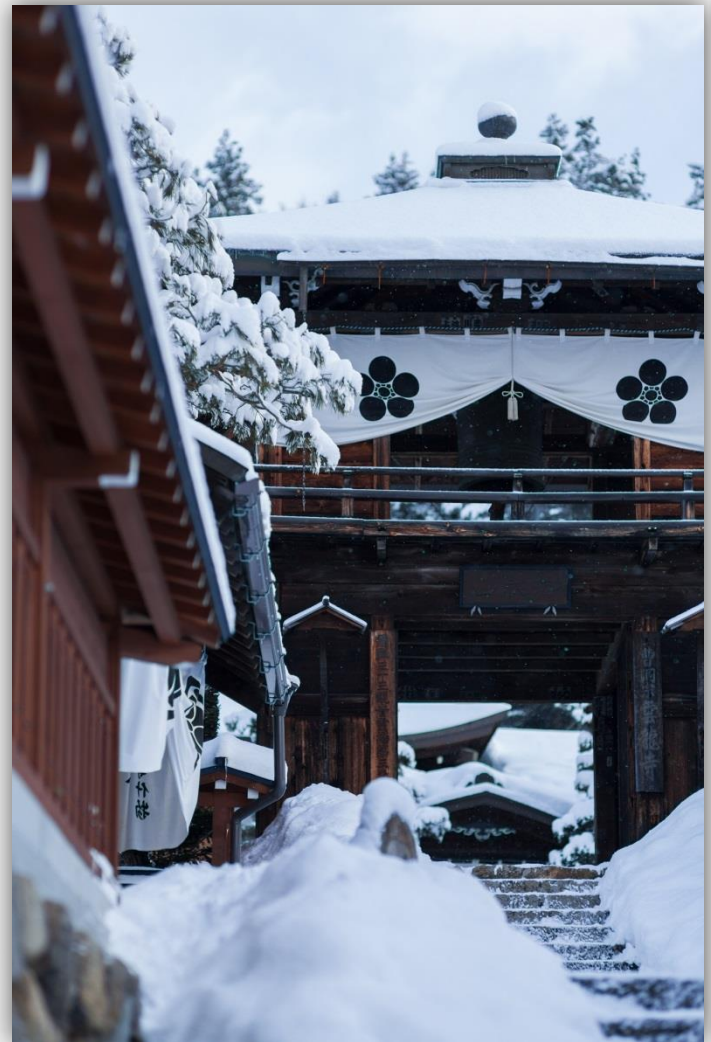


地域別売上高見通し（連結）（※）



※ 最終据付地ベースで集計しております。

経営課題の 進捗状況



(雪の東山寺町)

■ ニッチ市場のグローバル展開

- ・ 北米市場への展開
- ・ 欧州市場への展開
- ・ アジア市場への展開

■ 新製品の展開

■ 新分野の展開

■ 地域社会への貢献

ニッチトップ

高精度 ・ 高品質 ・ 高能率 ・ 全自動

硬脆材料の研削

世界の『ニッチ』市場を相手にトップをめざす



グローバル『ニッチトップ』戦略

北米市場への展開

北米におけるこれまでの営業活動により一定の見通し
ができたことから、米国に支店を開設する。
今後、営業活動とアフターサービスの拡充を進める。

ノースカロライナ州
シャーロット近郊
2018年4月1日 営業開始予定

- KENNAMETAL社工場
- SANDVIKグループ工場
- IMCグループ工場

欧州市場への展開

欧州市場では販売提携先のドイツHaas社との協業のもと、SANDVIKおよびIMCグループへの拡販を中心に欧米系メーカーへ営業展開中。



Hannover
EMO2017(9/18~23)

Augsburg
GrindTec2018(3/14~17)

Trossingen
Haas GrindDate 2017 (4/27~29)

- SANDVIKグループ工場
- IMCグループ工場
- KENNAMETAL社工場

アジア市場への展開

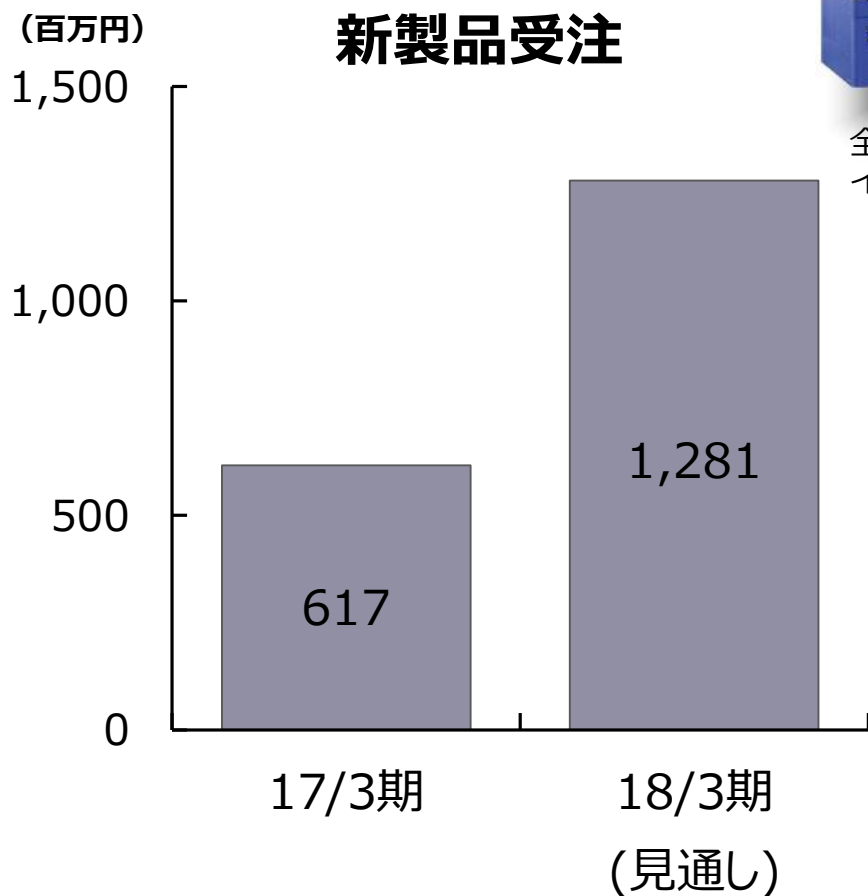
タイ、台湾、上海の各拠点相互に補完しながらアジア
広域をカバーできるよう、拠点機能の整備を進める。

台湾子会社での海外調達、
加工、組立については、
業務の拡大を進めさらに
事業の安定化を進める。
また営業拠点機能を付加し
台湾ローカルおよび台湾系
中国企業の攻略を進める。

● 当社 営業および
サービス拠点

新製品の展開

新製品受注



全自動溝入れ
インサート研削盤

GIG-202

高剛性複合
インサート研削盤

APX-105

インテリジェント
プロファイル研削盤

iPG-X

今期は国内の大手金型メーカー
と日系切削工具メーカーに加え、
切削工具の世界3大メーカーへ
の拡販に注力する。

新製品の展開（機械工業デザイン賞 受賞）



インテリジェント
プロフィール研削盤 **iPG-X**



機械工業デザイン賞

第47回
機械工業デザイン賞
日本商工会議所会頭賞

独自の技術開発力を基盤とする
デザイン開発が高く評価され、

APX-101（第45回受賞）

TGX-meV（第40回受賞）

UJG-75（第39回受賞）

に続く、4回目の受賞となりました。

- ・新機構の導入により精密金型の高精度自動加工を実現
- ・砥石自動交換等により、複雑形状の加工をこの一台で実現



半導体ウェーハ平面研削盤
SIG-V4



**サファイア
ウェーハ**



SiCウェーハ

- ・ LED素子用のサファイアウェーハ
 - ・ パワー半導体用のSiCウェーハ
- など、非常に硬い材料を精密研削する製品

既にSiCウェーハについて、各社様々な工程・工法で量産化が進められている。

SIG-V4は後発からの参入ではあるが、国内の大手自動車関連メーカーにてプロトタイプ機の製品評価を行っており、次のような評価をいただいている。

- ・ SiCウェーハを高速、高品質、低ダメージで研削可能
- ・ 安定して高品質を維持できる

現在、量産タイプの機械を開発しており、2018年中に完成させる予定。
大手自動車関連メーカーによる採用をめざす。

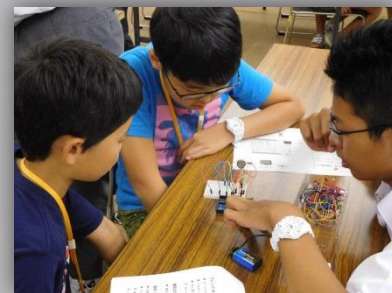


東大・和井田 ひと・ものづくりプロジェクト

<http://www.todai-mono-lab-japan.com/>



3Dプリンター体験



センサーを使った電子工作



ピタゴラススイッチに挑戦



マイスターと一緒に時計づくり

バーチャルな時代を生きる若い世代にリアルな “ものづくり” の楽しさを伝えるプロジェクト。

本社所在地である高山市の小学生を対象としたワークショップを5年連続開催。今年にはキャンプ形式で2017年8月に3日間集中開催。約20名が参加しました。



ご清聴ありがとうございました

本資料には、将来の業績見通し等を記載しておりますが、現時点での経済環境や事業方針など一定の前提に基づいて作成しております。従いまして、実際の業績は、需要変動や為替変動などの様々な要素により、業績見通しとは異なる結果となりうることをご承知ください。

<http://www.waida.co.jp>

問い合わせ先： 経営企画部

TEL:0577-32-0390 FAX:0577-37-0020

E-mail : ir@waida.co.jp